



IPC-7711C/7721C-AM1 SP

If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

En caso de conflicto entre la versión inglesa y las traducciones de este documento, prevalecerá la versión inglesa.

Retrabajo, Modificación y Reparación de Ensamblés Electrónicos

Enmienda 1

Desarrollado por el Sub-comité de Reparabilidad (7-34) del Comité de Aseguramiento del Producto (7-30) de IPC

Traducido por:
FOURCAD, Inc.,
Francisco Fourcade

Se recomienda a los usuarios de esta publicación que participen en el desarrollo de futuras revisiones.

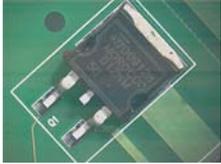
Contacto:

IPC

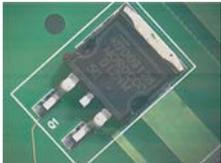
Tabla de Contenidos

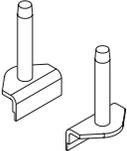
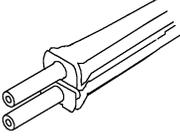
PARTE 2 Retrabajo

3.1.2 Extracción del D-Pak

Procedimiento	Descripción 	Tipo de Tarjeta	Nivel de Habilidad	Nivel de Conformidad
3.1.2	Método de Aplicación de Flux – Pinzas	R,F,W,C	Avanzado	Alto

5.9 Instalación del D-Pak

Procedimiento	Descripción 	Tipo de Tarjeta	Nivel de Habilidad	Nivel de Conformidad
5.9	Método de Aplicación de Flux – Punto-por-Punto	R,F,W,C	Avanzado	Alto

 7711 Retrabajo	Revisión: C Enmienda 1 Fecha: 7/20 Numero: 3.1.2 <h2 style="text-align: center;">Extracción del D-Pak</h2> <h3 style="text-align: center;">Método Pinzas</h3>		
		Tipo de Tarjeta: R,F,W,C Ver 1.4.2 Nivel de Habilidad: Avanzado Ver 1.4.3 Nivel de Cumplimiento: Alto Ver 1.5.1	

REQUISITOS GENERALES

Clausula 1.7 (Consideraciones básicas), 1.8 (Estaciones de trabajo, herramientas, materiales y procesos), y 1.9 (Libre de plomo) provee importante información y guía acerca del uso de este procedimiento, incluyendo, pero no limitando, a aleaciones de estaño-plomo y libre de plomo. Este procedimiento es también aplicable a productos libre de plomo.

EQUIPOS NECESARIOS

Estación/Sistema de Soldadura
Pinzas de Soldadura
Puntas Extractoras

MATERIALES

Soldadura con Núcleo de Flux
Flux
Limpiador

PROCEDIMIENTO

1. Retirar el recubrimiento de protección (si existe) y limpiar el área de cualquier contaminación, óxidos o residuos.
2. Instalar las puntas extractoras en las pinzas de soldadura.
3. Empezar con una temperatura aproximada en punta de 315 °C [599 °F] y cambiar conforme sea necesario.
4. Aplicar flux a la pista del plano térmico y a los terminales. (Ver Figura 1.)
5. Limpiar las puntas. Procedimiento 2.8
6. Estañar con soldadura los bordes internos e inferiores de las puntas extractoras (Ver Figura 2.)
7. Colocar las puntas extractoras sobre el componente y apretar las pinzas de soldadura haciendo contacto con la terminación y los terminales. (Ver Figura 3.)
8. Confirmar fusión de la soldadura en todas las uniones y levantar el componente del PCB. (Ver Figura 4.)
9. Separar el componente de las puntas extractoras limpiándolas sobre una superficie resistente al calor.
10. Re-estañar las puntas con soldadura y devolver la herramienta a su soporte.
11. Preparar las pistas para el reemplazo del componente. (Ver Figura 5.)
12. Limpiar en caso necesario e inspeccionar.

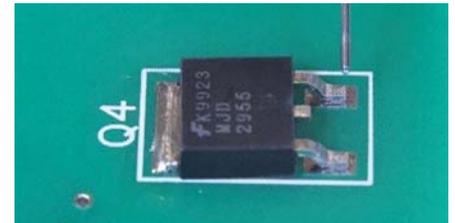


Figura 1 Aplicar Flux.



Figura 2 Estañar las Puntas con Soldadura.

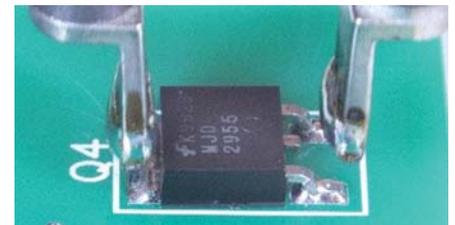


Figura 3 Colocar las Puntas sobre el Componente y Apretar las Pinzas.

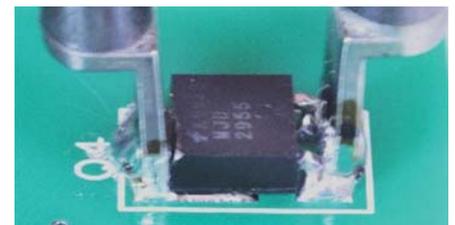


Figura 4 Confirmar la Fusión de la Soldadura y Levantar el Componente.

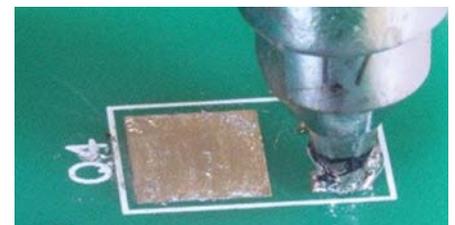


Figura 5 Preparar las Pistas para el Reemplazo del Componente.